2023-2029年中国电子级银粉产业发展现状与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司
www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国电子级银粉产业发展现状与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：http://www.cction.com/report/202308/395232.html

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司
订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838
海外报告销售: 010-69365838
Email: kefu@gonyn.com
联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

电子级银粉在银导电浆料中起着核心作用，其形貌结构、粒度及分布特性、松装及振实密度、比表面积、烧结性能、抗腐蚀性能等均会影响浆料的使用性能，而形貌结构特征和粒度特性是最关键的特性，直接或间接决定着其他性能。全球电子级银粉主要生产地区主要分布于日本及美国。主要生产企业包括日本DOWA、日本德力、美国Ames Goldsmith、美国Ferro、美国杜邦、瑞士Metalor等。其中日本DOWA因其电子级银粉产品粒径范围小、表面有机包覆好、分散性良好以及质量稳定特点，垄断局面明显，占全球50%以上的电子级银粉市场份额。目前国内能大规模供货的电子级银粉企业较少，绝大部分是进口产品或者外资在华合资企业生产。在国内电子级银粉市场上日本DOWA（日本同和）约占有70%市场份额，国产电子级银粉约占有30%市场份额。目前国内的苏州思美特表面材料科技有限公司、宁波晶鑫电子材料有限公司、苏州银瑞光电材料科技有限公司、广东羚光新材料股份有限公司等厂商电子级银粉质量在不断提升并实现量产，逐渐成为国内市场主要电子级银粉供应商。随着国产电子级银粉创新能力增强，其在产品供应、技术服务的及时性以及成本等方面有优势，国产电子级银粉替代空间较大。中企顾问网发布的《2023-2029年中国电子级银粉产业发展现状与未来前景预测报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第一章 我国电子级银粉概述
第一节 行业定义
第二节 行业特点和用途
第三节 电子级银粉产业链

第二章 国外电子级银粉市场发展概况
第一节 全球电子级银粉市场分析
第二节 亚洲地区主要国家市场概况
第三节 欧洲地区主要国家市场概况
第四节 美洲地区主要国家市场概况

第三章 2024年我国电子级银粉环境分析
第一节 我国经济发展环境分析

第二节 行业相关政策、标准

第四章 我国电子级银粉技术发展分析
第一节 当前我国电子级银粉技术发展现况分析
第二节 我国电子级银粉技术成熟度分析
一、球状电子级银粉制备工艺
二、片状电子级银粉制备工艺
第三节 中、外电子级银粉技术差距及其主要因素分析
第四节 未来提高我国电子级银粉技术的策略

第五章 电子级银粉市场特性分析
第一节 电子级银粉市场集中度分析及预测
一、中国电子级银粉市场竞争格局
二、中国电子级银粉主要生产企业及产能统计
第二节 电子级银粉SWOT分析及预测
一、优势电子级银粉
二、劣势电子级银粉
三、机会电子级银粉
四、风险电子级银粉
第三节 电子级银粉进入退出状况分析及预测

第六章 我国电子级银粉发展现状
第一节 我国电子级银粉市场现状分析
第二节 我国电子级银粉产量分析
一、我国电子级银粉生产区域分布
二、2018-2022年我国电子级银粉产量
第三节 2019-2023年我国电子级银粉市场需求分析
一、2019-2023年我国电子级银粉需求量
二、2022-2023年我国电子级银粉主要应用领域分布
第四节 我国电子级银粉价格趋势分析
一、2019-2023年电子级银粉价格分析
二、影响电子级银粉价格的因素

三、未来几年电子级银粉市场价格预测

第七章 2019-2023年我国电子级银粉行业经济运行
第一节 2019-2023年电子级银粉行业偿债能力
第二节 2019-2023年电子级银粉行业盈利能力
第三节 2019-2023年电子级银粉行业发展能力
第四节 2019-2023年电子级银粉行业企业数量及变化趋势

第八章 2015-2023年我国电子级银粉进、出口分析
第一节 2015-2023年中国电子级银粉进出口总量分析
一、2015-2023年中国电子级银粉进口量
二、2015-2023年中国电子级银粉出口量
第二节 2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进出口分析
一、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进口量
二、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉进口金额
三、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉出口量
四、2015-2023年中国平均粒径＜3微米的非片状电子级银粉出口金额
第三节 2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉进出口分析
一、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉进口量
二、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉进口金额
三、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉出口量
四、2015-2023年中国平均粒径＜10微米的片状电子级银粉出口金额

第九章 2019-2023年主要电子级银粉企业及竞争格局
第一节 日本DOWA
一、企业概况
二、产品结构
三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略
第二节 美国AMES GOLDSMITH
一、企业概况
二、产品结构

三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略
第三节 苏州银瑞光电材料科技有限公司
一、企业概况
二、产品结构
三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略
第四节 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
一、企业概况
二、产品结构
三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略
第五节 广东羚光新材料股份有限公司
一、企业概况
二、产品结构
三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略
第六节 江苏博迁新材料股份有限公司
一、企业概况
二、产品结构
三、2019-2023年公司电子级银粉销量
四、发展战略

第十章 2024-2030年电子级银粉投资建议
第一节 电子级银粉投资环境分析
第二节 电子级银粉投资进入壁垒分析
一、品牌壁垒
二、人才壁垒
三、技术壁垒
第三节 电子级银粉投资建议
一、技术开发战略
二、产业战略规划

三、业务组合战略
四、营销战略规划

第十一章 2024-2030年我国电子级银粉未来发展预测及投资前景分析
第一节 2024-2030年中国电子级银粉供给预测
第二节 2024-2030年中国电子级银粉需求预测

第十二章 2023-2029年业内对我国电子级银粉投资的建议及观点
第一节 投资机遇电子级银粉
第二节 投资风险电子级银粉
一、政策风险
二、市场竞争风险
三、技术风险
四、其他风险
第三节 行业应对策略
一、产品技术开发注意事项
二、谨慎投资增产
三、积极扩大出口

图表目录：

图表1：不同银粉对比
图表2：电子级银粉产业链
图表3：2023年全球白银储量分国家统计图
图表4：2023年全球白银储量区域分布格局
图表5：2015-2023年全球白银供给总量统计图
图表6：2015-2023年全球矿山银产量统计图
图表7：2023年全球矿山银产量分类型及区域统计图：百万盎司
图表8：2022-2023年全球矿山银产量分国家和地区排名：百万盎司
图表9：2014-2023年中国白银产量情况
图表10：2014-2023年中国矿山银产量情况
图表11：2017-2023年全球电子级银粉市场需求情况
图表12：2017-2023年亚洲部分国家电子级银粉市场需求情况

图表13：2017-2023年德国电子级银粉市场需求情况
图表14：2017-2023年美国电子级银粉市场需求情况
图表15：2015-2024年H1年中国GDP发展运行情况
图表16：2011-2024年H1中国居民人均可支配收入情况
图表17：2008-2024年H1中国城镇及农村居民收入及消费支出情况
图表18：2024年H1居民人均消费支出构成占比
图表19：2024年H1居民人均消费支出情况 单位：元
图表20：2016-2024年H1中国固定资产投资（不含农户）投资情况
图表21：2015-2024年H1中国社会消费品零售总额情况
图表22：2015-2024年H1中国货物进出口总额情况
图表23：银粉行业相关标准
图表24：我国电子化学品行业相关政策
图表25：部分省市电子化学品行业相关政策
图表26：我国及部分省市光伏银浆行业相关政策
图表27：不同形貌银粉简介
图表28：不同方法制备超细银粉的工艺优缺点对比
图表29：蒸发冷凝法制备球形银粉
图表30：硝酸银直接喷雾热分解和银化合物热分解-烧结制备球形银粉的工艺流程
图表31：银盐分解-包覆烧结法制备球形银粉的工艺流程
图表32：液相还原法制备球形银粉的工艺流程
图表33：液相还原法制备球形银粉和机械球磨法与化学还原法制备片形银粉
图表34：中国子级银粉主要生产企业及产能
图表35：2017-2023年中国电子级银粉行业销售平衡情况
图表36：我国银粉产业发展历程
图表37：2017-2023年中国电子级银粉产量情况
图表38：2017-2023年我国电子级银粉供需平衡统计图
图表39：2017-2023年我国电子级银粉需求分领域统计图
图表40：2017-2023年我国电子级银粉销售均价走势图
图表41：电子级银粉产品市场价格影响因素分析
图表42：2024-2030年我国电子级银粉市场规模预测图
更多图表见正文……

详细请访问：http://www.cction.com/report/202308/395232.html